

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60317-38

1992

AMENDEMENT 2
AMENDMENT 2
1999-10

Amendement 2

**Spécifications pour types particuliers de fils
de bobinage –**

Partie 38:

**Fil de section circulaire en cuivre émaillé
avec polyester ou polyesterimide et avec
surcouche polyamide-imide, classe 200,
avec une couche adhérente**

Amendment 2

**Specifications for particular types of
winding wires –**

Part 38:

**Polyester or polyesterimide overcoated with
polyamide-imide enamelled round copper wire,
class 200, with a bonding layer**

© IEC 1999 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

C

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 55 de la CEI: Fils de bobinage.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
55/704/FDIS	55/731/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 14

18 Adhérence par chaleur ou par solvant

Remplacer le texte existant par le nouveau texte suivant:

NOTE – Adhérence par solvant: essai nécessaire, mais qui n'est pas encore à l'étude.

18.1 Adhérence par chaleur

18.1.1 Force d'adhérence par chaleur d'un bobinage hélicoïdal

18.1.1.1 A température ambiante

Les éprouvettes doivent être préparées selon la méthode d'essai et la température de l'étuve pour le collage doit être fixée selon accord préalable entre l'acheteur et le fournisseur pour les différents types d'émaux adhérents. La température suggérée pour l'email adhérent polyamide est de (200 ± 2) °C et la température suggérée pour l'email adhérent polyamide aromatique est de (230 ± 2) °C.

Résultats: quand les éprouvettes sont essayées conformément à la méthode d'essai, aucune spire (en dehors de la première et de la dernière) ne doit se séparer sous l'action de la charge indiquée dans le tableau 2.

18.1.1.2 A température élevée

Les éprouvettes doivent être préparées et conditionnées conformément à la méthode d'essai.

La température élevée doit être fixée selon accord préalable entre l'acheteur et le fournisseur pour les différents types d'émaux adhérents. La température suggérée pour l'email adhérent polyamide est de (155 ± 2) °C et la température suggérée pour l'email adhérent polyamide aromatique est de (170 ± 2) °C.

Résultats: quand les éprouvettes sont essayées conformément à la méthode d'essai, aucune spire (en dehors de la première et de la dernière) ne doit se séparer sous l'action de la charge indiquée dans le tableau 2.

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 55: Winding wires.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
55/704/FDIS	55/731/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 15

18 Heat or solvent bonding

Replace the existing text by the following:

NOTE – Solvent bonding: test required but not yet under consideration.

18.1 Heat bonding

18.1.1 Heat bonding strength of a helical coil

18.1.1.1 At room temperature

The specimens shall be prepared according to the test method, and the temperature of the oven for bonding shall be fixed as agreed between purchaser and supplier for the different types of bonding enamels. The suggested temperature for polyamide bonding enamel is $(200 \pm 2) ^\circ\text{C}$ and the suggested temperature for aromatic polyamide bonding enamel is $(230 \pm 2) ^\circ\text{C}$.

Results: when testing the specimens according to the test method, under the action of load specified in table 2, no turns (other than possibly the first and the last) shall be separated.

18.1.1.2 At elevated temperature

The specimens shall be prepared and shall be conditioned as described in the test method.

The elevated temperature shall be fixed as agreed between purchaser and supplier for the different types of bonding enamels. The suggested temperature for polyamide bonding enamel is $(155 \pm 2) ^\circ\text{C}$ and the suggested temperature for aromatic polyamide bonding enamel is $(170 \pm 2) ^\circ\text{C}$.

Results: when testing the specimens according to the test method, under the action of load specified in table 2, no turns (other than possibly the first and the last) shall be separated.